

# 南京冠石科技股份有限公司

## 2023-2028 年中长期发展战略规划纲要

**重要提示：**本纲要是基于公司未来发展需要制定的战略规划文件。规划纲要涉及的公司未来发展规划、目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。在宏观经济环境和行业发展形势发生变化的情况下，公司可能根据实际情况对本规划做出适度调整。请投资者注意投资风险。

### 一、公司现状

公司深耕半导体显示行业，主营业务以半导体显示器件的研发、生产和销售为主，主营产品主要包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板、生产辅耗材等，可广泛应用于液晶电视、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴等带有显示屏幕的消费电子产品。公司目前已与京东方、华星光电、惠科、富士康、彩虹光电等国内外显示面板制造龙头企业建立了良好的合作关系，产品最终应用于华为、小米、OPPO、VIVO、海信、创维、苹果、三星等知名消费电子品牌商的畅销机型。经过多年发展，公司已在半导体显示细分领域具备较高的知名度与美誉度，行业地位不断提升。

### 二、总体战略目标

公司将继续以市场为导向，秉承“科学发展、客户至上、合作共赢”的经营理念，通过持续优化产品结构、丰富产品种类、不断深挖客户需求、加大研发投入力度等举措，完成“一大一小一微”的战略布局。其中“大”即布局大尺寸屏幕相关产业，以超高清（4K/8K）、大尺寸液晶面板及大尺寸偏光片为主导；“小”即布局小尺寸屏幕相关产业，以功能性器件、上游核心材料为主导；“微”即布局微电子生产核心材料相关产业，以半导体光掩膜版为主导。通过实施“一大一小一微”的发展战略，公司在半导体产业链上横向拓展、纵向延伸，深耕半导体显示领域的同时积极开辟第二增长曲线，将主营业务拓展至半导体产业链上其他重要环节，尤其是在半导体光掩膜版领域着力开拓，力争早日解决国家在相关领

域的“卡脖子”问题，助力我国半导体产业健康稳定的长久发展。同时，公司将继续以客户需求为出发点，以技术研发为驱动力，不忘初心，牢记使命，逐步将自身打造成为国内半导体产业细分领域的主力军和领跑者，以优良的经济效益和社会效益回报社会和股东。

### 三、业务发展规划

#### （一）产品开发计划

在液晶面板方面，随着 5G 时代的到来，网络内容传输速度大幅提升，为超高清（4K/8K）、大尺寸液晶电视的普及与推广提供了极大助力，在消费升级推动下，显示面板大尺寸化已成为行业发展趋势。在此背景下，公司对客户需求、行业趋势以及市场变化快速做出准确判断，积极布局超高清（4K/8K）、大尺寸液晶面板产业，确保在细分市场具备先发优势。

在功能性器件方面，公司持续看好下游消费电子市场发展，未来将重点针对折叠屏幕、车载显示屏幕、5G 技术等应用前景广阔的新型显示领域持续开发新的功能性器件产品，在满足客户需求的同时，为下游消费电子产品向智能化、轻薄化、便携化、多功能化、集成化、高性能化发展提供助力。

在偏光片方面，公司计划进军车载显示市场，为车载显示屏幕提供配套的偏光片产品。随着汽车的普及和物联网的快速发展，车载显示屏幕已不仅是新型汽车的标配产品，更是实现“人车交流”的重要媒介。车载显示偏光片作为车载显示屏幕的重要组成部分，具有形状复杂、定制化生产等特点，技术门槛及产品附加值较高，能够产生良好的经济效益。

在半导体掩膜版方面，公司已在浙江省宁波市投资建设半导体光掩膜版生产基地，全部投产后可实现 45-28nm 半导体光掩膜版的规模化生产。光掩膜版作为半导体产业链上游重要的原材料之一，是微电子相关产品制造过程中的图形转移工具或母版，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。目前，我国高精度半导体光掩膜版产品主要仍依赖于进口，国产化率极低。随着公司半导体光掩膜版产品的规模化生产，将进一步打破国外厂商技术和市场垄断，提高我国在半导体关键材料领域的自主保障能力，有效解决“卡脖子”问题，助力我国半导体产业健康稳定的长久发展。

## （二）产业链延伸计划

显示行业是半导体产业的重要应用领域，公司自聚焦显示行业以来，始终坚持以产业链延伸为发展方向，不断丰富产品种类、丰富产品结构，现已在显示行业上游材料端及中游制造端有所建树，主营产品涵盖偏光片、功能性器件、信号连接器、生产辅耗材等重要显示器件以及超高清（4K/8K）、大尺寸液晶面板产品。未来，公司将以现有优势业务为立足点，进一步向半导体产业链上的其他重要领域横向拓展、纵向延伸，在上游材料端重点发展半导体光掩模版业务，使其成为公司未来跨越式发展的有力支撑。待时机成熟时，公司计划进一步向产业链上游其他核心材料端挺进，以实现我国半导体产业关键环节自主可控为己任。

## （三）技术研发计划

公司将继续保持务实的研发风格，以改善生产工艺、提升生产效率、适时推出新产品为研发目标，立足市场，强化创新主体意识，整合外部技术资源，提高研发投入强度，不断完善技术研发体系。公司在日本筹建研发中心，未来将充分利用当地在半导体领域的先进技术资源，重点在上游材料领域自主研发攻关，通过将研发成果反哺国内市场的方式快速提升公司的综合技术实力及核心竞争力，完成向技术型企业的转型升级。

## （四）人才扩充计划

未来，公司将重点引入以下两类人才：一类是精通管理、熟悉半导体产业、具备国际化视野的高级管理人才；另一类是具备专业知识、在半导体产业拥有多年从业经历的高级技术人才。公司通过做大做强，为新老人才提供充足的展业空间和良好的事业发展平台，使得各类人才在与企业共同成长的过程中能够形成强烈的归属感，增强人才稳定性。未来，公司将加强对各级人员的培训，帮助员工提高工作技能和职业素质，不断完善薪酬与绩效考核制度，提高员工的福利待遇，并建立长效的激励机制，力争打造一支团结凝聚、精干高效、蓬勃向上的人才队伍。

## （五）降本增效计划

有效降低成本、保持利润持续增长是企业生存发展的重中之重。今后，公司

将继续强化成本控制，通过精细化管理优化工作流程，使用 ERP 系统和 MES 系统对生产成本进行严格的管理和控制，有效降低材料损耗。

## 四、战略保障措施

为保证本战略规划的实施以及战略目标的实现，公司在公司治理、体制机制、人才体系、资本化运作、风险控制等方面加强管理，提升效率。

### （一）公司治理和企业管理

公司将进一步建立健全公司制度体系，完善各项议事规则，持续优化公司治理结构，构建更加高效、规范的管理体系，通过制度化、信息化、流程化的管理优化，确保公司运营质量和效率随着公司规模的不壮大而不断提升。在确保生产经营稳定的同时，进一步加强风险管理，从制度层面上助力公司实现战略目标。

### （二）体制机制

以合理公平为原则，不断完善适合公司发展阶段的体制机制。科学制定公司各部门、各子公司年度绩效目标，适时施行包括股权激励等多种激励手段，充分调动员工积极性。激发全体员工的主观能动性和工作积极性，在实现公司发展、股东权益、社会价值增长同时，员工也能感受到公司发展成果的获得感、荣誉感和价值感。

### （三）人才体系

吸引及保留关键人才，以市场为导向，提倡精简高效的薪酬理念，建立健全激励机制，确保公司具有可持续发展的内在动力。深化梯队建设，打造结构优、活力足、业务强的人才梯队。通过健全和完善优秀人才的选拔、培养、培训、激励机制，切实提高各类优秀人才队伍的素质和凝聚力、执行力与生产力。

### （四）资本化运作

围绕公司战略实施，以服务公司业务发展为宗旨，公司将结合自身现金流情况，合理有效发挥资本市场的优势，适时推动通过股权融资、债券融资、并购基金、战略合作等多种方式，满足项目投资和各类生产经营活动的资金需求。

## （五）风险控制

完善风控模型，根据不同业务所处行业、阶段，构建多层次风控体系，推动向价值创造型风险管理转型，全面提升风险控制水平，有效控制风险事项。